

Prof. Dr.-Ing. E. Reithmeier

REM-Topografiemessungen an mikro- und nanostrukturierten Oberflächen

Von der Fakultät für Maschinenbau der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktor-Ingenieur

genehmigte Dissertation von

Dipl.-Math. Taras Vynnyk

Prof. Dr.-Ing. E. Reithmeier

1. Referent: Prof. Dr.-Ing. E. Reithmeier

Institut für Mess- und Regelungstechnik

2. Referent: Prof. Dr.-Ing. J. Seume

Institut für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik

Vorsitz: Prof. Dr.-Ing. habil. P. Nyhuis

Institut für Fabrikanlagen und Logistik

Tag der Promotion: 10.11.2009

Berichte aus dem Institut für Mess- und Regelungstechnik der Leibniz Universität Hannover

Taras Vynnyk

REM-Topografiemessungen an mikro- und nanostrukturierten Oberflächen

Shaker Verlag Aachen 2010

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Zugl.: Hannover, Leibniz Univ., Diss., 2009

Umschlag:

Das Hintergrundbild zeigt eine Kollage vom Institutsgebäude an der Leibniz Universität Hannover aus verschiedenen Zeitepochen. Gestaltung: K. Salfeld

Copyright Shaker Verlag 2010 Alle Rechte, auch das des auszugsweisen Nachdruckes, der auszugsweisen oder vollständigen Wiedergabe, der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen und der Übersetzung, vorbehalten.

Printed in Germany.

ISBN 978-3-8322-9062-7 ISSN 1615-7184

Shaker Verlag GmbH • Postfach 101818 • 52018 Aachen Telefon: 02407 / 95 96 - 0 • Telefax: 02407 / 95 96 - 9 Internet: www.shaker.de • E-Mail: info@shaker.de

Vorwort

Die vorliegende Dissertation entstand während meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher

Mitarbeiter am Institut für Mess- und Regelungstechnik der Leibniz Universität Hannover.

Dem Leiter des Instituts für Mess- und Regelungstechnik, Herrn Prof. Dr.-Ing. E. Reithmeier,

gilt mein großer Dank für die wissenschaftliche Förderung sowie für die Übernahme des 1.

Referats. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Prof. Dr.-Ing. J. Seume, Leiter

des Instituts für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik, für die Übernahme des 2. Referats.

Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. P. Nyhuis, Leiter des Instituts für Fabrikanlagen und Logistik,

danke ich sehr für die Übernahme des Vorsitzes.

Mein herzlicher Dank geht an alle Mitarbeiter des Instituts für das angenehme Arbeitsklima

und für die Hilfsbereitschaft.

Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie für die Anregung zur Wissenschaft und

insbesondere bei meiner Frau Lena für ihre Unterstützung, Geduld und ihr Verständnis

bedanken.

Hannover, November 2009

Taras Vynnyk

Kurzfassung

In dieser Arbeit wird ein mathematisches Modell der Signalentstehung in einem Rasterelektronenmikroskop (REM) mit zwei gegenüberliegenden Everhart-Thornley-Detektoren vorgestellt. Auf Basis des Modells wird eine verbesserte photometrische Auswertemethode entwickelt, die aus REM-Aufnahmen eine Oberflächentopografie mit einer lateralen Auflösung von bis zu 20 nm rekonstruieren kann. Im Gegensatz zur klassischen photometrischen Methode, der eine Lambertsche Winkelverteilung der Emissionselektronen sowie die sekansförmige Abhängigkeit der Emissionsausbeute zugrunde liegen, werden diese Anforderungen in der verbesserten Methode abgeschafft. Darüber hinaus ermöglicht das vorgestellte Verfahren eine 3D-Rekonstruktion von Oberflächen unabhängig von den Emissionseigenschaften verschiedener Materialien. Hierfür wird eine robuste numerische 3D-Integration entwickelt, die auf die Fourieranalyse zurückgreift und den Einfluss der Störanteile eliminiert.

Zur Validierung des entwickelten Modells hinsichtlich der Genauigkeit der rekonstruierten Oberfläche und der Auflösungsgrenze werden verschiedene technische Oberflächen gemessen und untersucht. Zum Vergleich werden sowohl optische als auch taktile Messverfahren (Rasterkraftmikroskop - AFM) herangezogen. Darüber hinaus wird beispielhaft eine Genauigkeitssteigerung durch die Fusion von REM- und optisch gewonnenen Messdaten vorgestellt.

Zur Charakterisierung von Messdatensätzen mit periodischen Strukturen werden zwei Methoden vorgestellt, die auf der Fourier- bzw. Splineapproximation basieren.

Stichworte: Rasterelektronenmikroskop, Photometrische Methode, "Shape from Shading", Sekundärelektronen, Rückstreuelektronen, Fourier 3D-Integration

Abstract

In this paper a mathematical model of signal occurrence in a scanning electron microscope (SEM) with 2 oppositely positioned Everhart-Thornley detectors is presented. Based on this model an improved photometric method was developed that allows measuring a surface topography with a lateral resolution of 20 nm. In comparison to the classic photometric method the efficiency of the detector system is taken into account and the requirements of the cosine Lambert's law for the angle distribution of emitted electrons as well as secant-shaped dependency of the emission's coefficient on the inclination angle are suppressed. Furthermore, the presented method provides a 3D-reconstruction of the surface independent from the emission properties of different materials. For this purpose a robust 3D-integration was developed to which the Fourier analysis was applied to eliminate the influence of noise components.

The developed model was tested on different measurement objects and analysed with regard to accuracy and resolution limits. For comparison optical measuring method and atomic force microscope (AFM) measuring method were applied. In addition an improvement of the accuracy using an example of the fusion of SEM- and optically measured data is shown.

Finally, the characterization of the measured dataset with periodical structures based on the Fourier and spline approximation is presented.

Keywords: Scanning Electron Microscope, photometric method, shape from shading, secondary electrons, backscattered electrons, Fourier 3D-Integration

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitu	ng und Zielsetzung	1
2	Existier	ende Methoden für die Oberflächenerfassung	3
	2.1 Tak	ctile Messungen	3
	2.2 Erf	assung der Oberfläche mittels optischer Methoden	5
	2.2.1	Weißlichtinterferometer	5
	2.2.2	Konfokales Mikroskop	6
	2.2.3	Numerische Apertur und deren Einfluss auf die Qualität der Messung	7
	2.3 RE	M – Auswertung	11
	2.3.1	REM Aufbau	11
	2.3.2	Photogrammetrische Auswertung REM - Aufnahmen	13
	2.3.3	Analyse des Detektorsignals von regulären Strukturen	14
	2.3.4	Klassische photometrische Methode	16
	2.3.5	Nachteile der klassischen photometrischen Methode	17
3	Theoret	ische Betrachtung der verbesserten photometrischen Methode	19
	3.1 Uni	tersuchung von sekundären und Rückstreuelektronen	19
	3.1.1	Streuprozesse	19
	3.1.2	Elektronenreichweite und Definition von SE- und Rückstreuelektronen	20
	3.1.3	Totale Emissionsausbeute, Winkel- und Energieverteilung	21
	3.1.4	Empirische Formeln zur Berechnung von Emissionskoeffizienten	23
	3.1.5	Empirische Formeln zur Berechnung von Winkelverteilungen	28
	3.1.6	Resultierende Parameterauswahl	32
	3.2 Pho	otometrische Methode	33
	3.2.1	Rekonstruktion von konvexen Oberflächen	34
	3.2.2	Berücksichtigung des Wirkungsgrades der Detektoren und der nicht	
		Lambertschen Emissionsverteilung	38
	3.2.3	Rekonstruktion von beliebigen Oberflächen	48
	3.2.4	Festlegung der Systemparameter	51
	3.2.5	Zeiteffektive Berechnung der Horizontkurve	56
	3.2.6	Numerische Integration	63
4	Experin	nenteller Aufbau und die Messergebnisse	75
	4.1 Exp	perimentelle Aspekte bei der Oberflächenerfassung mit dem	
		Rasterelektronenmikroskop	75

Inhaltsverzeichnis

	4.1.1	Ausgleich der Detektorverstärkungen	76
	4.1.2	Einfluss des Magnetfeldes	78
	4.1.3	Zeitliche Änderung der Detektorsignale	80
	4.1.4	Ortsabhängige Empfindlichkeit von Detektoren	82
	4.1.5	Erfassung von größeren Oberflächen	84
	4.1.6	Azimutale Ausrichtung des Detektorsystems	87
	4.2 Me	essablauf und Ergebnisse	90
	4.2.1	Kugel	91
	4.2.2	Ribletstrukturen	93
	4.2.3	Holografisches Beugungsgitter	95
	4.3 Ko	mbinierte Auswertemethode	97
	4.3.1	Datenanpassung	98
	4.3.2	Datenverschmelzung	99
5	Charak	terisierung der Messergebnisse	101
	5.1 An	passung des Profils mit der Fourier-Reihe	102
	5.2 An	passung des Profils mit B-Splines	105
6	Zusamı	nenfassung und Ausblick	109
7	Literati	urverzeichnis	111

Abbildung 1:	Morphologische Filterwirkung einer Tastnadel an Strukturen	3
Abbildung 2:	Links: taktile Messung an einer Rillenstruktur. Rechts: taktile Messung an	
	derselben Oberfläche, die jedoch abgeformt wurde. Die verwendete	
	Tastnadel hat einen Radius von 5 µm	4
Abbildung 3:	Funktionsprinzip eines Weißlichtinterferometers	5
Abbildung 4:	Funktionsprinzip eines konfokalen Mikroskops	6
Abbildung 5:	Abhängigkeit zwischen dem Öffnungswinkel des Objektivs und der NA	7
Abbildung 6:	Problem der direkten Lichtreflexion an geneigten Flächen	7
Abbildung 7:	Rückstreuung des Lichts an Oberflächen mit verschiedener Rauheit	8
Abbildung 8:	Intensitätsverteilung des Schnittverlaufs durch den Bilderstack für	
	unterschiedlich hergestellte Proben	9
Abbildung 9:	Fehlerhafte Interpolation der Fehlstellen. Links - REM - Aufnahme der	
	lackierten Oberfläche, rechts - optisch aufgenommene und interpolierte	
	Oberfläche	9
Abbildung 10:	Funktionsprinzip des Rasterelektronenmikroskops	. 11
Abbildung 11:	Intensitätsverteilung des Primärelektronenstrahls	. 12
Abbildung 12:	Typische REM - Aufnahme. Die Flanken sind heller als die horizontalen	
	Bereiche	. 12
Abbildung 13:	Abhängigkeit der totalen Elektronenausbeute vom Neigungswinkel	. 12
Abbildung 14:	Schematisches Prinzip der photogrammetrischen Rekonstruktion	. 13
Abbildung 15:	REM - Aufnahmen mit unterschiedlichem Neigungswinkel. Die Pfeile	
	kennzeichnen gleiche Topografiepunkte, deren Ähnlichkeit insbesondere	
	im rechten Bild nicht mehr zu erkennen ist	. 14
Abbildung 16:	Das Strukturprofil und die entsprechende Modellfunktion	. 15
Abbildung 17:	2-Detektorsystem	. 16
Abbildung 18:	Abschattungseffekte bei konkaven Profilen (links) und das	
	Rekonstruktionsschema (rechts)	. 17
Abbildung 19:	Ablenkung von emittierten Elektronen durch den Einfluss des	
	elektrischen Sammelfeldes und mehrfache Ionisation.	. 18
Abbildung 20:	Emission von Elektronen durch Ionisierung	. 21
Abbildung 21:	Die Energieverteilung der gesamten Emissionsausbeute	. 22
Abbildung 22:	Experimentell ermittelte E_{max} -Werte und die Regressionsgerade	. 24

Abbildung 23:	Abhängigkeit des Rückstreukoeffizienten von der Primärenergie und von	
	dem Neignungswinkel der Probe	.25
Abbildung 24:	Emissionsausbeute als Funktion der Primärenergie	.27
Abbildung 25:	Energie- und Winkelverteilung von sekundären Elektronen. Die	
	Energieverteilung (links) ist auf den maximalen Wert normiert. Die	
	Winkelverteilung (rechts) hängt nur von dem Winkel ψ zwischen der	
	Austrittsrichtung und dem Oberflächennormal ab.	.28
Abbildung 26:	Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Lambertschen und	
	quantenmechanischen Verteilungen	.29
Abbildung 27:	Quantenmechanische Verteilung und die Approximationsverteilung	
	(links), die Soll-Ist-Differenz der beiden Verteilungen (rechts)	.30
Abbildung 28:	Winkelverteilung von Rückstreuelektronen in Abhängigkeit vom	
	Neigungswinkel der Probe	.31
Abbildung 29:	Normalisierte Energie als Funktion der Ordnungszahl	.32
Abbildung 30:	Energiespektrum der Rückstreuelektronen	.32
Abbildung 31:	Winkelverteilungen der totalen Emissionsausbeute	.33
Abbildung 32:	Emission im globalen (links) und lokalen (rechts) Koordinatensystem	.35
Abbildung 33:	Berechnung des Grenzemssionswinkels	.37
Abbildung 34:	Feldverteilung in einem 2D-Schnitt durch die Probenkammer	.39
Abbildung 35:	Detektionsverhalten bei unterschiedlichen Elektronenbahnen (links) und	
	korrespondierende Detektionsmatrix (rechts)	.40
Abbildung 36:	Detektionsmatrizen für Emissionselektronen mit der kinetischen	41
Abbildung 37:	Zonenaufteilung für emittierte Elektronen	.42
Abbildung 38:	Elektronenfluss durch elementare Fläche	.42
Abbildung 39:	Berechnung des nicht registrierten Anteils für eine beliebige Oberfläche	.49
Abbildung 40:	Detektorsignale und experimentell ermittelte Signalrelationen	.52
Abbildung 41:	Bestimmung der Position von der Kalibrierkugel	.54
Abbildung 42:	Ergebnis der Modellanpassung bei der Approximationswinkelverteilung	.56
Abbildung 43:	Berechnung des minimalen Steigungswinkels	.57
Abbildung 44:	Interpolation in den Zwischenstellen	.58
Abbildung 45:	Berechnung der Horizontkurve auf mehreren Rechnern	60
Abbildung 46:	Zeitliche Entwicklung von GPU und CPU	60
Abbildung 47:	Architektur von einer CPU (links) und voneiner GPU (rechts)	61

Abbildung 48	: CUDA Softwaremodell (links) und Hardwarearchitektur des GPUs	
	(rechts)	62
Abbildung 49:	Integration des Rauschens	64
Abbildung 50:	Fehlerhafte Rekonstruktion des Signals bei der Überschreitung der	65
Abbildung 51:	Fehlerhafte Rekonstruktion von aperiodischen Profilen	.70
Abbildung 52:	Schematischer Ablauf der Periodisierung	.71
Abbildung 53:	Aufteilung in Subbereiche	.72
Abbildung 54:	Integration des normal verteilten Rauschens. Standardmethode (links),	
	Fourier-Integration (mitte), Kombinationsverfahren (rechts)	.73
Abbildung 55:	DSM940 mit 2 um 180° versetzten ET-Detektoren	.76
Abbildung 56:	Aufbau des Everhardt-Thornley Detektors	.77
Abbildung 57:	Intensität als Funktion des Rotationswinkels um die z-Achse	.78
Abbildung 58:	Durch das Magnetfeld hervorgerufene virtuelle Änderung des	
	Neigungswinkels	.79
Abbildung 59:	Positive Ladung der Probe bei der Bestrahlung mit niederenergetischen	
	Elektronen	.80
Abbildung 60:	Zeitliche Änderung der mittleren Detektorintensität	81
Abbildung 61:	Ermittlungsschema der Empfindlichkeitsfunktionen	. 82
Abbildung 62:	Empfindlichkeiten des 2-Detektorsystems	. 83
Abbildung 63:	Typische Aufnahmekonstellation	.85
Abbildung 64:	Stitching-Ergebnis für parallel ausgerichtete trapezförmige Strukturen	. 86
Abbildung 65:	Stitching-Ergebnis für schrägausgerichtete trapezförmige Strukturen	. 86
Abbildung 66:	Winkel zwischen dem Detektorsystem und der Abtastrichtung	.87
Abbildung 67:	Aufbau der Objektivlinse (links) und Verteilung der magnetischen	
	Flussdichte entlang der optischen Achse (rechts)	. 88
-	Abhängigkeit der Strukturwinkel vom Arbeitsabstand	
Abbildung 69:	Das lokale und globale Koordinatensystem	.89
Abbildung 70:	Vergleich der gemischten partiellen Ableitungen vor und nach der	
	Drehwinkelkorrektur	90
Abbildung 71:	3D-Rekonstruktion einer Stahlkugel: 1 - Rekonstruktionsergebnis, 2 und	
	3 – markierte Diagonalprofile und korrespondierende Profile einer	
	Idealkugel, 4 und 5 – Soll-Ist Differenz für markierte Profilschnitte und 6 $$	
	- Gesamtabweichung von der idealen Kugel	.92
Abbildung 72:	Ermittelte Signalrelation k_x von der Stahlkugel	.93

Abbildung 73:	Ideales Ribletprofil93
Abbildung 74:	Rekonstruierte Ribletoberfläche und Vergleich mit dem
	Referenzmessdatensatz für ideale Ribletstrukturen94
Abbildung 75:	Rekonstruierte Ribletoberfläche und Vergleich mit dem
	Referenzmessdatensatz für geschliffene Ribletstrukturen95
Abbildung 76:	Messungen des holografischen Beugungsgitters mit dem konfokalen
	Mikroskop96
Abbildung 77:	Vergleich zwischen den REM- und AFM-Messergebnissen97
Abbildung 78:	Skizze zur Erläuterung der Profilentstehung (links) und Ermittlung der
	Phasenverschiebung als Funktion der Schnittnummer (rechts)99
Abbildung 79:	Abbott-Kurve und Gewichtskoeffizient $k(z)$
Abbildung 80:	Ergebnisse der Messdatenfusion
Abbildung 81:	Vermessung von Drallstrukturen. Der aufgenommene Messdatensatz
	(rechts) beinhaltet 2 Drallstrukturen: 4 Wellen/mm und 20 Wellen/mm101
Abbildung 82:	Herstellung der approximierten Oberfläche
Abbildung 83:	Auswirkung des Leakage-Effekts
Abbildung 84:	Ermittlung der dominanten Welle

Formelzeichen und Abkürzungen

Abkürzungen

REM Rasterelektronenmikroskop
ET- Detektor Everhardt-Thornley Detektor

BSE Rückstreuelektronen (eng. <u>backs</u>cattered <u>e</u>lectrons)
SE Sekundäre Elektronen (eng. <u>s</u>econdary <u>e</u>lectrons)

SE1 Sekundären Elektronen, die durch primäre Elektronen angeregten wurden
SE2 Sekundären Elektronen, die durch Rückstreuelektronen angeregten wurden
SE3 Sekundäre Elektronen die Kollision von Rückstreuelektronen mit der

Probenkammer entstehen

NA Numerische Apertur

CPU Hauptprozessor (eng. <u>C</u>entral <u>P</u>rocessing <u>U</u>nit)
GPU Grafikprozessor (eng. <u>G</u>raphics <u>P</u>rocessing <u>U</u>nit)
ALU Recheneinheit (eng. <u>A</u>rithmetic <u>L</u>ogic <u>U</u>nit)
CUDA Compute Unified Device Architecture

DFT/FFT Diskrete/Schnelle (eng. Discrete/Fast) Fouriertransformation

Formelzeichen

Vertikaler Emissionswinkel (Winkel zwischen dem Geschwindigkeitsvektor ψ , θ des Emissionselektrons und dem Oberflächennormal in dem Emissionsort) Azimutaler Emissionswinkel (Winkel zwischen den Projektionen des α, β, γ Geschwindigkeitsvektor des Emissionselektrons und der X-Achse auf die tangentialen Ebene in dem Emissionsort) Emissionsausbeute der Rückstreuelektronen (Rückstreukoeffizient) η Emissionsausbeute der sekundären Elektronen (SE-Koeffizient) δ Gesamt Emissionsausbeute σ Faltungsoperator $f_{\sigma}(E)$ Energieverteilung der gesamten Emissionsausbeute Winkelverteilung der gesamten Emissionsausbeute $f_{\sigma}(\psi)$

 $f_{\eta}(E)$ Energieverteilung von Rückstreuelektronen

 $f_{\eta}(\psi)$ Winkelverteilung von Rückstreuelektronen

Formelzeichen und Abkürzungen

Energieverteilung von sekundären Elektronen $f_{\delta}(E)$ Winkelverteilung von sekundären Elektronen $f_{\delta}(\psi)$ EpPrimärelektronenenergie ZOrdnungszahl des Probenmaterials Einfallswinkel des Primäreletronenstrahls φ W_{ρ} Austrittsarbeit $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ Partielle Ableitungen der Oberflächenfunktion in X- und in Y- Richtung Lokaler Neigungswinkel der Messprobe zu den X- und Y-Achsen ψ_x, ψ_y Absorptionskoeffizient der Elektronenkanone Absorptionskoeffizient der Messprobe τ_{ob} Minimaler Emissionswinkel, bei dem Elektronen von der Oberfläche nicht $\varphi_{min}(\alpha)$ absorbiert werden [...] ganzzahliger Anteil Signale von den entlang der X-, Y-Achsen ausgerichteten Detektoren 1 und 2 I_{1x} , $I_{1y} I_{2x}$, I_{2y} k_1, k_2 Koeffizienten der Approximationswinkelverteilung